

## 导热凝胶

### 【产品概述】

SE500AB 是一种柔软的双组份硅树脂基导热缝隙填充材料，具有高导热率、低界面热阻及良好的触变性，是大缝隙公差场合应用的理想材料。它填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触、减小热阻，快速有效地降低电子元件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。SE500AB 可通过手工方式或点胶设备来进行涂装，固化后为弹性体，可以保护元器件。

### 【产品图示】



### 【产品应用】

- 硬盘、手机
- 光学精密设备
- 笔记本电脑
- 移动及通讯设备
- 汽车发动机控制设备
- 高端工控及医疗电子等领域

**【储存&运输】** 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输

**【包装】** 50cc 或 400cc。

**【有效期】** 本产品有效期为 12 个月

**【安全】** 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS)》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。

特性参数 SE500AB			
产品性能	测试结果		测试标准
混合前	A 组分	B 组分	
颜色	粉红色	粉红色	目视
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.2	3.2	氦气真密度法
混合比例	1:1		N/A
在架寿命@25°C (月)	6	6	N/A
混合后性能			
颜色	粉红色		目视
体积电阻	>10 <sup>13</sup> Ω cm		ASTM D257
导热系数	5.0W/m.K		ASTM D5470
介电击穿强度	>200VAC/mil		ASTM D149
介电常数	5.0		ASTM D150
最小介面厚度	0.09mm		N/A
使用温度	-50~200°C		N/A
硅小分子析出 D3~D12 含量	<300PPM		GB/T 27843-2011
热膨胀系数	175ppm/K		ASTM E831
阻燃性	V-0		UL
表干时间@25°C (Min)	20		N/A
完全固化时间			
25°C (H)	4		N/A
100°C (min)	10		N/A
固化后硬度 (Shore oo)	50~90°		ASTM D2240
RoHS	PASS		IEC 62321
Halogen	PASS		EN14582
REACH	PASS		EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具，记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

注：厚度公差为±10%，硬度公差为±5°，颜色/厚度/硬度均可按客户需求调试。